PERIPHERAL MASS MEMORY SUBSYSTEM

Patent number:

JP4219815

Publication date:

1992-08-10

Inventor:

CARTEAU DANIEL; SCHRECK PHILIPPE; GIACOMINI

PATRICIA

Applicant:

BULL SA

Classification:

- international:

G06F3/06; G06F13/12

- european:

Application number: JP19910069318 19910308

Priority number(s):

Also published as:

】 EP0445479 (A1) 】 US5325488 (A1)

FR2659460 (A1)

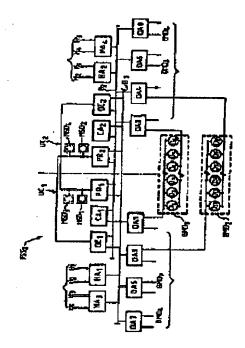
EP0445479 (B1)

Report a data error here

Abstract of JP4219815

PURPOSE: To obtain a system which manages not only the transfer of data from a central unit to a mass memory, but also the reading and writing of data to and from the mass memory instead of the central unit.

CONSTITUTION: This system includes two control units UC1 and UC2 which belong to an information processing system including one of central hosts H1 -H4, and are so constituted as to control one of mass memories BMD1 and BMD2, and equipped with plural structure elements PR1 -PR2, DE1 -DE2, CA1 -CA2, HA1 -HA2, and DA1 -DA2 connected to an independent power source and 1st and 2nd parallel buses B1 and B2. Then the system includes microsoftware architecture which is so constituted as to execute commands to the host and inform the host of state changes of the mass memories BMD1 and BMD2, characteristic of the structure elements PR1 -PR2, DE1 -DE2, CA1 -CA2, and DA1-DA2, and mounted on the hardware structure of the elements.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平4-219815

(43)公開日 平成4年(1992)8月10日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示簡所

G06F 3/06

301 H 7165-5B

R 7165-5B

13/12

310 E 7230-5B

審査請求 有 請求項の数12(全 17 頁)

(21)出願番号

特願平3-69318

(22)出顧日

(32)優先日

平成3年(1991)3月8日

(31)優先権主張番号 9002962

(33)優先権主張国

1990年3月8日 フランス (FR) (71)出願人 390035633

ブル・エス・アー

フランス国、75116・パリ、アプニユ・ド

ウ・マラコフ、121

(72)発明者 ダニエル・カルト

フランス国、78180・モンテイニ・ル・ブ

ルトヌー、プラス・ジョルジュ・ポンピド

ウ、6

(72)発明者 フイリツプ・シユルク

フランス国、78310・モルパ、リユ・ド

ウ・ロレンヌ、13

(74)代理人 弁理士 川口 義雄 (外2名)

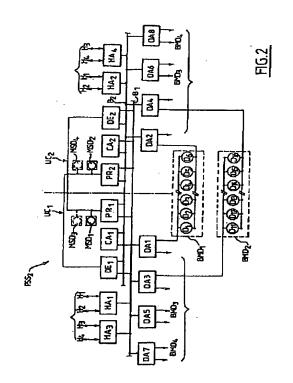
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 周辺マスメモリサブシステム

(57)【要約】 (修正有)

【構成】1つのセントラルホスト (H1, H2, H3, H₁)を含む情報処理システムに属しており、1つのマ スメモリ(BMD1, BMD2, ...,)を制御する ように構成され且つ独立電源(ALIM1, ALIM2, BAT₁, BAT₂) と、第1及び/又は第2の並列型バ ス(B₁, B₂)に接続された複数の構造エレメント(P R_1-PR_2 , DE_1-DE_2 , CA_1-CA_2 , HA_1-H A₂, DA₁-DA₂) とを夫々有する2つのコントロー ルユニット(UC1, UC2)を含む周辺マスメモリサブ システム (PSS1, PSS2)。本サプシステムは、ホ ストのコマンドを実行すると共にマスメモリの状態変化 をホストに知らせるように構成され、各々が各々のコン トロールユニットの構造エレメントに固有であり且つ該 エレメントのハードウェア構造に搭載されるマイクロソ フトウェアアーキテクチャを含むことを特徴とする。

【効果】本発明はあらゆる型の情報処理システムに有効 に適用可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つのセントラルホストを含む情報処理システムに属しており、少なくとも1つのマスメモリを制御するように構成され且つ独立電源と、第1及び/又は第2の並列型パスに接続された複数の構造(ハードウェア+マイクロソフトウェア)エレメントとを失々有する2つのコントロールユニットを含む周辺マスメモリサプシステムであって、該サプシステムが、ホストのコマンドを実行すると共にマスメモリの状態変化をホストに知らせるように構成されており、各々が各々のコントロールユニットの各々の構造エレメントに固有であり且つ該エレメントのハードウェア構造に搭載される複数の機能マイクロソフトウェアサプアセンブリから形成されるマイクロソフトウェアアーキテクチャを含むことを特徴とする周辺マスメモリサプシステム。

【請求項2】 ホストが第1のコントロールユニットに 属する少なくとも1つの第1のホストアダプタを介して 2つのパスの少なくとも一方に接続されており、マスメ モリが第1及び第2のコントロールユニットに属する少 なくとも1つの第1及び第2のマスメモリアダプタを介 20 して2つのパスの各々に接続されており、ホストアダプ タとメモリアダプタとが部分的に同形のハードウェア構 造を有しており、コントロールユニットの各々の他の構 造工レメントが部分的に同形のハードウェア構造を有す ることを特徴とする請求項1に記載のサプシステム。

【請求項3】 各機能サブアセンブリが特定の機能に各々対応する1組のモジュールを含んでおり、いくつかのモジュールがサブアセンブリ間で同一であることを特徴とする請求項1又は2に記載のサブシステム。

【請求項4】 ホストアダプタ及びディスクアダプタ以 30 外に、各コントロールユニットの構造エレメントがセントラルプロセッサ、ソリッドステートディスクユニット及びキャッシュメモリであり、各コントロールユニットのセントラルプロセッサ、ソリッドステートディスクユニット及びキャッシュメモリが夫々相互に同一であり、一方のユニットの構造エレメントの各々が他方のユニットの対応するエレメントと同一であることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のサブシステム。

【請求項5】 ホストアダプタ及びマスメモリアダプタがドーターボードに関連付けられるマザーボードを各々 40 含んでおり、マザーボードが構造的に相互に同一であり、以下のハードウェアコンポーネント、即ちマスメモリに書き込み又は読み取りすべきデータブロックを受け取るバッファメモリと、帰属するアダプタの機能を制御するためのマイクロプロセッサと、対応するアダプタに固有の機能サブアセンブリのマイクロソフトウェアモジュールの種々の命令とデータとを受け取るRAM型メモリと、対応するアダプタをコントロールユニットの他の構造エレメントに接続するためのマイクロプロセッサと、2つのバスの少なくとも一方との接続用インターフ 50

2

ェースとを備えており、これらのコンポーネントがコントロールマイクロプロセッサの内部パスに接続されていることを特徴とする請求項4に記載のサブシステム。

【請求項6】 ホストアダプタのドーターボードがセントラルホストとの接続用インターフェースを含んでおり、マスメモリアダプタのドーターボードがマスメモリとの接続用インターフェースを備えていることを特徴とする請求項5に記載のサプシステム。

【請求項7】 セントラルプロセッサ、ソリッドステー トディスクユニット及びキャッシュメモリがドーターボ ードに接続されるか又はされない少なくとも1つのマザ ーポードを各々含んでおり、ハードウェアが互いに同一 のマザーボードが以下のハードウェアコンボーネント、 即ち2つのバスと接続するための2つのインターフェー スと、2つのバスによりサブシステムの他の構成要素で ある構造エレメントと接続するための2つのマイクロコ ントローラと、対応する構造エレメントのコマンド用マ イクロプロセッサと、パッファメモリと、対応する構造 エレメントに固有のサブアセンブリの種々のマイクロソ フトウェアモジュールとそのコマンドマイクロプロセッ サにより処理されるデータとを含むRAM型メモリとを 備えており、これらの種々のコンポーネントが同一のコ マンドマイクロプロセッサの同一の内部バスに接続され ていることを特徴とする請求項4に記載のサプシステ ム。

【請求項8】 ホストアダプタに固有の機能サブアセン プリHが、該サプアセンプリHを構成する種々のモジュ ール間の連係作業を組織するホストアダプタのオペレー ティングシステムに関するモジュールMoと、アダプタ が接続された並列型バスを介してホストアダプタ及び他 の構造エレメントにしたがって情報の転送を管理するた めのモジュールMiと、ホストインターフェースを管理 するためのモジュールM2と、ホストアダプタのRAM 型メモリに含まれるコマンドスタックを管理するための モジュールM3と、ホストによりコントロールユニット にアドレスされるコマンドを実行するためのモジュール M₄ と、セントラルホストからマスメモリへのコマンド を受け取り、これらのコマンドをマスメモリアダプタに 経路指定するためのモジュールMsと、ホストアダプタ のハードウェアコンポーネントの一方又は他方にエラー が検出された場合にリスタート及びエラー処理するため のモジュールM₆と、ホストアダプタのパッファメモリ を管理するためのモジュールM10とを含むことを特徴と する請求項6に記載のサプシステム。

【請求項9】 マスメモリアダプタに固有の機能サプアセンプリDが、ホストアダプタのモジュールと同一のモジュールMo, M1, M3, Me, M1oと、セントラルホストからマスメモリへのコマンドを翻訳するためのモジュールMoとを含むことを特徴とする請求項8に記載のサブシステム。

【請求項10】 ソリッドステートディスクユニットの サプアセンブリが、ホストアダプタのモジュールと同一 のモジュールMo, M1, M3, M6, M10と、セントラル ホストから対応するソリッドステートディスクユニット へのコマンドを翻訳するためのモジュールMoとを含む ことを特徴とする請求項8に記載のサブシステム。

【請求項11】 キャッシュメモリのサプアセンプリC がモジュールMo, M1と、キャッシュメモリのテーブル を管理するためのモジュールMilとを含むことを特徴と する請求項8に記載のサプシステム。

【請求項12】 セントラルプロセッサの機能サプアセ ンプリPがモジュールMo及びMI以外に、対応するコン トロールユニットを初期化するためのモジュールM 12と、2つのコントロールユニット間の通信用モジュー ルであって、該ユニットの一方を構成する構造エレメン トの一つが使用不能の場合に、該ユニット間に情報交換 を設定するように特に構成されたモジュールMisと、対 応するセントラルプロセッサによりコマンドされるコン トロールユニットの電源を管理するためのモジュールM 11と、電源が切断された場合に対応するセントラルプロ セッサによりコマンドされるコントロールユニットのコ ンテキストを救済するためのモジュールMisと、電源が 切断され、モジュールM16により救済が行われた後に、 対応するソリッドステートディスクユニットの書き込み 又は読み取りオペレーションをリスタートするためのモ ジュールM17と、パックアップディスクメモリと関連す るセントラルプロセッサとの間のインターフェースを管 理するためのモジュールMisとを備えることを特徴とす る請求項8に記載のサプシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は周辺マスメモリサプシス テムに係る。より詳細には、本発明は該サブシステムの ハードウェア及びマイクロソフトウェアアーキテクチャ に係り、あらゆる型の情報処理システムに適用可能であ る。

[0002]

【従来の技術】情報処理システムが少なくとも1つのセ ントラルプロセッサ及び該プロセッサが接続された1つ の主記憶装置から形成される少なくとも1つの中央処理 装置即ちセントラルホストと、複数の周辺装置と、主記 憶装置と種々の周辺装置との間のデータ交換の制御を確 保する少なくとも1つの入出力プロセッサとから構成さ れることは知られている。

【0003】種々のコントロールユニット即ちコントロ ーラが種々の周辺装置に関連付けられており、セントラ ルホストと種々のコントローラに関連付けられる周辺装 置との間のデータの物理的転送を確保する。

【0004】一般に、同一の地理的位置において情報処

レメントを担持する種々のポードとその電源との間のデ ータ転送を確保する同一の並列バスに接続されている。

【0005】現在最も汎用されているバスはMultibus 1 I (Intel社の登録商標) である。そのアーキテクチャは Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 規格1296により規格化された並列型の主バスを 中心に構築される。

【0006】最も頻用されている周辺装置としては回転 磁気ディスクメモリ又は光ディスクメモリのようなマス メモリがある。マスメモリは非常に大量の情報を保存し 且つ比較的迅速に情報にアクセスすることができるの で、非常に広く使用されている。その平均アクセス時間 は約20~25ミリ秒である。市販の最高性能のディス クメモリの容量は1ギガバイトを越える。

【0007】マスメモリとしては、半導体メモリを使用 する電子メモリ又は電子ディスク(又はソリッドステー トディスク)として知られるメモリが現在開発中であ る。そのアクセス時間は1ミリ秒(即ち最高性能の回転 ディスクメモリのアクセスタイムの数十分の1)を大幅 に下回り、回転部分を備えない。しかしながら、その単 位記憶容量コストは高く、磁気ディスクメモリの約20 倍である。もっとも、エレクトロニックメモリの単位記 **憶容量コストは回転磁気ディスクメモリよりも著しく迅** 速に低下しつつあり、このコストは数年以内に等しくな るだろうと考えられる。したがって、情報処理システム の周辺装置として回転磁気ディスクメモリとソリッドス テートディスクとを同時に使用すると有用であると考え られる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】情報処理システムの構 造はますます複雑になっており、ますます多数のエレメ ントが必要になっている。更に、このようなシステムに より処理すべきデータ量は極めて甚大であり、システム のセントラルプロセッサにより処理する前に多数のマス メモリを使用してこれらのデータを保存する必要があ る。その結果、このようなシステム全体を中央処理装置 により管理するのは著しく複雑である。

【0009】したがって、夫々システムのエレメントの 一部、特に周辺装置を管理する複数のサプシステムのレ ペルに、情報処理システムを構成するエレメントアセン ブリに管理を分散させることが望ましい。

【0010】本発明の目的は明確には、セントラルユニ ットの代わりにセントラルユニットからマスメモリへの データの転送のみならずマスメモリへの情報の読み書き を管理する周辺マスメモリサプシステムを提供すること である。

【0011】このようなサプシステムはできるだけ使用 し易く且つ高性能でなければならない。

【0012】更に、データへのアクセスは完全に保護さ 理システムを構成する全機能エレメントは、これらのエ 50 れなければならず、即ち一部又は全体の故障時であろう

と、システムのエレメントの全体又は一部の保守のためのダウン時間であろうと状況に関係なく、サプシステムにより管理されるマスメモリに含まれる任意のデータに常にアクセスできなければならない。

【0013】換言するならば、セントラルホストはサプシステムがマスメモリを実際にどのように管理するかを気遣う必要なく、サプシステム又はマスメモリに影響し得る誤動作とは無関係に、サプシステムにより管理されるマスメモリに含まれる任意のデータにアクセスできなければならない。これはホストにとってデータの可用性 10 を規定する。

[0014]

【課題を解決するための手段】このために、本発明の周辺マスメモリサプシステムはMultibus II型の2つの並列バスを中心に構築されたモジュラーハードウェアアーキテクチャにしたがって構成され、種々の型のハードウェアエレメント(ロジックボード)の数は著しく少ない。これらのハードウェアエレメントは相互に同形の部分を有しており、これらの種々のハードウェアエレメントに搭載されたマイクロソフトウェアアーキテクチャは20同様にモジュラー型であり、所定のハードウェアエレメントに夫々搭載される複数の機能サプアセンブリを含み、マイクロソフトウェアアーキテクチャのサプアセンプリはマイクロソフトウェアモジュールから形成され、モジュールの一部はサプアセンブリ間で共通である。

[0015]

【作用】本発明によると、少なくとも1つのセントラルホストを含む情報処理システムに属しており、少なくとも1つのマスメモリを制御するように構成され且つ独立電源と、第1及び/又は第2の並列型パスに接続された 30複数の構造 (ハードウェア+マイクロソフトウェア) エレメントとを夫々有する2つのコントロールユニットを含む周辺マスメモリサブシステムは、ホストのコマンドを実行すると共にマスメモリの状態変化をホストに知らせるように構成されており、各々が各々のコントロールユニットの各々の構造エレメントに固有であり且つ該エレメントのハードウェア構造に搭載される複数の機能マイクロソフトウェアサブアセンブリから形成されるマイクロソフトウェアアーキテクチャを含むことを特徴とする。 40

[0016]

【実施例】本発明のその他の特徴及び利点は添付図面に 関する以下の詳細な説明に明示される。

【0017】図1は本発明の周辺マスメモリサブシステムの第1の実施態様PSSIを示す。

【0018】サプシステムPSS1は例えば2つのセントラルホストH1及びH2を含むより大型の情報処理システムに属する。

【0019】サプシステムPSS1は好ましくは2つの同一のコントロールユニット、即ち図1の左側のUC1

と右側のUC2とを含む。

【0020】サプシステムPSS1のハードウェアアーキテクチャは好ましくはMultibus II型の相互に並列な2つの同形のパスB1及びB2の周囲に構築され、該パスは相互に完全に正対する中心ゾーンと、相互に正対しない2つの側部ゾーンとを有する。

【0021】2つのコントロールユニットUC1及びUC2は厳密に同形であり、対称面PSに関して相互に対称である。

【0022】第1のコントロールユニットUC1は第1の電源ALIM1により電気エネルギを供給され、パッテリBAT1により構成される第1の緊急電源手段に接続されている。

【0023】同様に、第2のコントロールユニットUC は第1の電源から独立した第2の電源ALIM2により 給電され、第2の緊急電源BAT2に接続されている。

【0024】第1のコントロールユニットUC₁は以下の構造エレメント、即ち第1のセントラルプロセッサPR₁と、ソリッドステートディスクユニットDE₁と、ホストアダプタHA₁、マスメモリ(マスメモリは6つのディスクメモリD₁~D₆を有するパンクBMD₁から形成される)アダプタ(本明細書中では簡単にするためにディスクアダプタと呼称する)DA₁と、バックアップディスクメモリMSD₁と、キャッシュメモリCA₁を含み、1つの構造エレメントはハードウェア構造とこの構造に搭載されたマイクロソフトウェアサプアセンプリとの組み合わせとして規定される。

[0025].

【0026】同様に、第20コントロールユニットUC 2は第20セントラルプロセッサPR2と、第20ソリッドステートディスクユニットDE2と、ホストアダプタHA2と、第20ディスクアダプタDA2と、第20パックアップディスクメモリMSD2と、第20キャッシュメモリCA2とを含む。

【0027】第1及び第2のディスクアダプタDAi及びDAzは夫々のリンクCSi及びCSaを介してディスクメモリバンクBMDiに接続されている(図1には6つのディスクメモリ即ちDi~Deのみを示す)。該ディスクアダプタは更にリンクCSz及びCSiを介して第2のディスクメモリバンクBMDz(図1には簡単にするために図示せず)に接続されている。

【0028】リンクCS1~CS4は、American National Standards Institute (ANSI) 及びInternational Standard Organization (ISO) により規格化されたIPI-2型である。

【0029】第1のホストアダプタHA1は第1の接続 チャネルCE1により第1のホストH1に接続され、第2 の接続チャネルCE2により第2のホストH2に接続され ている。

50 【0030】同様に、第2のホストアダプタHA2は第

1の連結チャネルCEsにより第2のホストH2に接続さ れており、第2の接続チャネルCE,により第1のホス トHIに接続されている。

【0031】この場合、第1及び第2のホストアダプタ HAI及びHAzの第1の連結チャネルCEI及びCEaは 第2の連結チャネルCE2及びCE1よりも優先される。

【0032】 4つの接続チャネルCE₁~CE₁はANSI (及びISO) により規格化されたIPI-3型である。

【0033】第1のコントロールユニットを構成する全 構造エレメント即ちPRi, DEi, HAi, DAi, MS 10 夕DAi, DAa及びDAaとを含む。 D₁及びCA₁は、ハードウェア及び及びマイクロソフト ウェアの両面から見て第2のコントロールユニットUC 2の対応するエレメント即ちPR2, DE2, HA2, DA 2, MSD2及びCA2と同形であり、面PSに関して相 互に対称に配置されている。

【0034】6つの構成エレメントDE1, DE2, PR 1, PR₂, CA₁, CA₂は、2つのパスB₁及びB₂パス の相互に正対している中心部分でこれらのバスに同時に に接続されている。

【0035】第1のコントロールユニットUC1の構成 20 らかである。 エレメントHAI及びDAIは第1のパスBSIに接続さ れ、第2のコントロールユニットUC2の対応するエレ メントHA2及びDA2は第2のパスB2に接続されてい

【0036】第1のバックアップディスクメモリMSD 」は、SCSI型のリンクL」を介して第1のセントラル プロセッサPR₁と第2のソリッドステートディスクユ ニットDE2とに接続されている。

【0037】同様に第2のバックアップディスクメモリ MSD2は、SCSI型のリンクL2を介して第2のセン 30 トラルプロセッサPR₂と第1のソリッドステートディ スクユニットDE」とに接続されている。したがって、 2つのバックアップディスクメモリMSD1及びMSD2 は同時に第1及び第2のコントロールユニットUC1及 びUCzからアクセス可能である。

【0038】2つのバックアップディスクメモリは、電 源ALIM₁及びALIM₂(図1では簡単にするために 図示せず) に夫々接続された2つの入力を有する〇R回 路により電圧を供給される。

【0039】図2に示す本発明の周辺マスメモリサブシ ステムの第2の実施態様PSS2は、図1に示した第1 の実施態様PSS」の拡張形でより高性能である。該サ プシステムは同様に2つのパスB,及びB2の周囲に構築 されると仮定される。該サプシステムは同様に2つの同 形のコントロールユニットUC1及びUC2を含む。該コ ントロールユニットの各々はエレメントPR₁, DE₁, CAI, MSDI, DAI及びHAI (ユニットUCI) と、PR2, DE2, CA2, MSD2, DA2及びHA z(ユニットUC₂)とを含んでおり、これらのエレメン トは図1の対応エレメントと全く同一の参照符号を付 50

し、厳密に同一の役割及び機能を有する。6つのディス クメモリDı~Deから構成されるディスクメモリパンク BMD₁ は図1と同様に2つのディスクアダプタDA₁及

【0040】第1のコントロールユニットUCiは、更 にホストアダプタHA: と3つのディスクアダプタD A3, DA5, DA7とを含む。

びDAzに接続されている。

【0041】同様に、第2のコントロールユニットUC 2は、更にホストアダプタHA、と3つのディスクアダプ

【0042】ホストアダプタHA1及びHA3と4つのデ ィスクアダプタDAi, DAs, DAs及びDAzとはバス B2に接続されており、ホストアダプタHA2及びHA。 とディスクアダプタDA2, DA1, DA6, DA8とはバ スB」に接続されている。

【0043】上記の他のエレメント、即ちセントラルプ ロセッサPR1, PR2、キャッシュメモリCA1, CA2 及びソリッドステートディスクユニットDE1, DE2は 同時に2つのバスB1及びB2に接続されていることが明

【0044】2つのディスクアダプタDA3及びDA 4は、例えば6つのデイスクメモリD11~D16により構 成されるディスクメモリバンクBMD2に接続されてい

【0045】同様に、ディスクアダプタDAs及びDAs とDA₇及びDA₈とは、夫々例えば6つのディスクメモ リD21~D2e及びDs1~Dse(図2には簡単にするため の図示せず)により構成されるディスクメモリバンクB MDs及びBMD、に夫々接続されている。

【0046】ディスクアダプタに接続されたディスクメ モリの数が十分に多い場合、コントロールユニットUC 」及びUC2は夫々第1のセントラルプロセッサPR」及 び第2のソリッドステートディスクユニットDE₂と、 第2のセントラルプロセッサPR₂及び第1のソリッド ステートディスクユニットDE1とに夫々接続された補 助パックアップディスクメモリ(例えばMSD3及びM SDィ)を含み得る。

【0047】本発明の周辺サプシステムは図2に示す以 外のホストアダプタ及びディスクアダプタを含んでもよ いことが明らかであり、これらの補助ディスクアダプタ は他の磁気ディスクメモリバンク、例えば光ディスクメ モリパンク、テープ駆動装置又は磁気光学ディスクメモ リ等に接続される。換言するならば、木発明の周辺マス メモリサプシステムは多数の可能な機器構成を含むこと ができ、多大な記憶容量を有するマスメモリを管理する ことができる。

【0048】本発明のサプシステムのディスクメモリは (UC1又はUC2のホスト及びディスクアダプタを介す る) デュアルアクセス型であることが理解されよう。 更 に、ユニットUC1及びUC2の各々が同形であり且つ2

つのバスB1及びB2に接続されているため、互換可能で ある。その結果、UC1の構造エレメントの1つが(例 えば全体又は一部の故障、保守又は移動のために) 使用 不能な場合にUC₂の対応するエレメントで代替するこ とができる。同様に、ユニットUCI又はUC2の一方が 使用不能な場合(電源が切断された場合、又は保守作業 中) には他方のユニットで代替する。二重のMultibus I 1を有する完全に冗長な本発明の周辺サプシステムの構

造 (ハードウェア及びマイクロソフトウェアの両方) は

用性とを確保する。

【0049】ホストアダプタ(例えばHA」)及びディ スクアダプタ(例えばDA」)のより詳細なハードウェ ア構造を図3に示す。アダプタ夫々HA2~HA4及びD A2~DA6のハードウェア構造はHA1及びDA1につい て以下に記載する対応する構造と完全に同形であること が理解されよう。

【0050】ホストアダプタHAIは、接続チャネルC E1及びCE2によりセントラルホストH1及びH2に接続 するための(上記IPI-3規格により規定される型の)イ ンターフェース I H1と、好適態様によると約512~ 768KBの容量を有するホストパッファメモリ(簡単 にホストパッファと呼称する) MTH₁と、ホストアダ プタの機能を制御するマイクロプロセッサMPH」(例 えばRISC型のAMD 29000マイクロプロセッ サ)と、マイクロプロセッサMPHIに関連するRAM 型メモリであって、例えばホストアダプタHA1に搭載 されるマイクロソフトウェアモジュールの種々の命令を 受け取るように構成された1つのRAM型メモリとデー 夕のための1つのRAM型メモリ(夫々命令及びデータ に充てられるこれらの2つのRAM型メモリは例えば各 々256Kの容量を有する)とから構成されるRAM型 メモリRAH₁と、パスB₁を介してホストアダプタをコ ントロールユニットの他のエレメントと接続するための マイクロコントローラMCHiと、上記IEEE規格1296に より規定されるMultibus IIバスB」との接続用インター フェースであって、例えば本発明の周辺サプシステムP SS1, PSS2の他の構成エレメントとメッセージモー ドで通信するVL 82c389コプロセッサ (Intel社製) によ り構成されるインターフェースIBHュとを含む。

【0051】上記ホストアダプタの全構成エレメントは マイクロプロセッサMPH」の内部パスBI」により相互 に通信する。

【0052】ディスクアダプタDA1のハードウェア構 造はホストアダプタHAIのハードウェア構造と同様で ある。

【0053】即ちアダプタDA1は、上記IEEE規格 1296により規定されるパスB」との接続用接続イン ターフェース I BD」と、ディスクメモリD」~D。に書 き込むべきデータ又は骸ディスクメモリに書き込まれた 50

データの読み取りに由来するデータのためのバッファメ モリ(より簡単にディスクパッファと呼称する)MTD 」と、ディスクアダプタのコマンドマイクロプロセッサ MPD₁と、相互接続用マイクロコントローラMCD ·と、マイクロプロセッサMPD·に関連するRAM型メ モリRAD1と、接続チャネルCS1及びCS2を介して ディスクメモリバンクBMD1に接続するためのインタ 一フェースID」(このインターフェースは上記IPI 2規格により規定される)とを含む。

10

データの完全な保護とセントラルホストH₁のデータ可 10 【0054】ホストアダプタ及びディスクアダプタHA 1及びDA1のハードウェア構造は、マザーボード及びド ーターボードから構成される。

> 【0055】即ちホストアダプタHA」は、マザーボー ドCMH₁とドーターボードCFH₁とを含み、ディスク アダプタDA」はマザーボードCMD」とドーターボード CFDiとを含む。

> 【0056】マザーボードСМН」は上記エレメントM TH₁, MPH₁, RAH₁, MCH₁, IBH₁を含み、 マザーボードCMDiはエレメントMCDi, MTDi, RADi, MPDi及びIBDiを含む。

【0057】ドーターボードCFH」はインターフェー ス I H₁を含み、ドーターボードCFD₁はインターフェ ース I Di を含む。

【0058】2つのマザーボードCMH,及びCMD,は 厳密に同形であり、したがってホスト及びディスクアダ プタHA1及びDA1はドーターボードCFH1及びCF D₁以外は同一のハードウェアを有することが理解され よう。マザーボードCMH1, CMD1は、Mutibus II型 の単一パス(例えばB1)に接続できるという意味でmon o-Multibus II型である。

【0059】コントロールユニットUC1の種々の構造 エレメントPR1, CA1, DE1のハードウェア構造を 図4に示す。

【0060】これらのエレメントPR₁, CA₁, DE₁ の各々はマザーポード夫々CMPI、CMCI及びCMD ;と、少なくとも1つのドーターボードCFC;及びCF Dı (夫々CAı 及びDAı の場合)とから形成される。

【0061】種々のマザーボードCMPi, CMCi及び CMD1は同一のハードウェア構造を有する。

【0062】即ち、マザーボードСMP;は、いずれも 内部パス5に接続されたハードウェアコンポーネント1 ~8を含み、マザーボードСМС1は、いずれも内部バ ス15に接続されたハードウェアコンポーネント11~ 18を含み、マザーボードCMD」は、いずれも内部パ ス25に接続されたハードウェアコンポーネント21~ 28を含む。

【0063】ハードウェアコンポーネント1~8、11 ~18及び21~28は夫々上記順序で相互に同形であ る。即ち、エレメント1、11及び21は相互に同形で あり、エレメント2, 12, 22は相互に同形であり、

以下同様である。したがって、ハードウェアコンポーネ ント11~18及び21~28を認識するためには、ハ ードウェアコンポーネント1~8について説明すれば十 分である。

【0064】コンポーネント1及び2はパスB1及びB2 との通信用インターフェースであり、上記インターフェ ースIBHI及びIBDIと同一型である。

【0065】2つのコンポーネント3及び4は、パスB 1及びB2により周辺サプシステムの他の構成エレメント と接続するためのマイクロコントローラである。これら 10 のマイクロコントローラは、上記マイクロコントローラ MCHi 及びMCDi と同一型の例えばIntel 80c32型マ イクロコントローラである。

【0066】コンポーネント6はセントラルプロセッサ PR₁を構成するコンポーネント全体のコマンドマイク ロプロセッサである。該マイクロプロセッサはRISC 型のAMD 2900マイクロプロセッサからなり、し たがって、上記マイクロプロセッサMPH、及びMPD と同形である。

TD₁ 及びMTH₁ に等しい) の容量を有するバッファメ モリであり、コンポーネント8は図3に関して上述した と同一型のメモリ(即ちRAH₁及びRAD₁)と同一の RAM型メモリである。したがってコンポーネント8 は、セントラルプロセッサPR」に含まれる種々のマイ クロソフトウェフモジュールの命令を含む1つのRAM 型メモリと、マイクロプロセッサ6により処理されるデ 一夕のための1つのRAM型メモリとにより構成され る。

【0068】マザーボードCMPi, CMCi, CMDi は、bi-Multibus II型のマザーボードである。

【0069】セントラルプロセッサPR:のマザーボー ドCMP₁は更に、セントラルプロセッサとDE₂とをバ ックアップディスクメモリMSDiに接続するリンクLi とのインターフェースであるハードウェアコンポーネン ト9を含む。インターフェースはしたがってIPI-2 規格型である。

【0070】同様に、ソリッドステートディスクユニッ トのマザーボードCMD1は、PR2及びDE1をMSD2 に接続するリンクL2とのインターフェースを構成する コンポーネント29を含む。

【0071】ソリッドステートディスクユニットDE: のドーターボードCFD: はこのユニットのメモリプレ ーンを構成し、例えばRAMメモリの複数のカラム(カ ラム1 R1, . . . , 1 R , . . . , 1 R) を含む。

【0072】このメモリプレーンCFDiから又は該メ モリプレーンへの情報(データ及びこれらのデータがメ モリプレーンCMD1のRAMの内側で位置付けられる アドレス)はパスBDA」を通って輸送され、該パスは このメモリプレーンのRAMメモリカラム全体に供給す 50 12

るに十分な数のプランチに分割している(ソリッドステ ートディスクユニットが第2のメモリプレーンを含む場 合、該ユニットはBDA1と同一型のパスにより第1の ドーターボードCFD₁に接続された第2のドーターボ ードCFD2により構成される)。

【0073】キャッシュメモリCA1のドーターボード CFC₁はドーターボードCFD₁と同一である。

【0074】このドーターボードCFC1はキャッシュ メモリCAiのメモリプレーンを含んでおり、複数の並 列RAM型カラム2R1, ...,

..., 2R により構成され、これらの列の組は バス (データ及びアドレスバス) BDA2 によりマザー ポードСМС1のパッファメモリ17に接続されてい

【0075】したがって本発明の周辺サプシステムのハ ードウェアアーキテクチャは、一般にホストアダプタ及 びディスクアダプタのマザーボードと、セントラルプロ セッサ、キャッシュメモリ及びソリッドステートディス クユニットのマザーボードとの単に2つの型のマザーボ 【0067】コンポーネント7は512~768K(M 20 一ドの周囲に構築されることが明らかである。これらの エレメントの各々により確保される機能にしたがって異 なる型の1以上のドーターボードがこれらの2つの型の マザーボードの各々に関連付けられる。

> 【0076】この非常に簡単な構造は、Multibus II型 の一方及び/又は他方のパスに接続されたエレメント全 体が同一のポードホルダマガジンの内側に配置されてい る点と相俟って非常に経済的である。更に、製造中に極 めて迅速に組み立てることができる。

【0077】図5について説明すると、本発明の周辺サ プシステムのマイクロソフトウェアアーキテクチャAM Lは5つの主なマイクロソフトウェアサプアセンプリ P, H, D, C, Sを含み、該サブアセンブリはP R_1 , HA_1 ($HA_2 \sim HA_4$), DA_1 ($DA_2 \sim D$ As), CA1 (CA2) 及びDE1 (DE2) のハードウ ェア構造に夫々搭載されている。

【0078】各サプアセンプリは夫々特定の機能を有す る所定数のモジュールから構成される。所定のモジュー ルはサプアセンブリ間で共通である。

【0079】同一のサプアセンプリのモジュールは、R AMメモリに配置された共通メモリゾーン(例えばRA H1, RAD1, 8, 18, 28) により又は相互間の直 接呼出しにより相互に通信する。

【0080】異なるサプアセンプリに属するモジュール は、MultibusIIを規定するIEEE規格により規定されるよ うなMultibusIIメッセージにより相互に通信し、これら のメッセージはデータについては請求メッセージであ り、要求、応答及び通告については非請求メッセージで

【0081】図5に示す5つのマイクロソフトウェアサ プアセンプリ以外に、全ハードウェア構造に共通し且つ

該ハードウェア構造の各々に含まれるマイクロコントロ ーラ(即ちマイクロコントローラMCH1, MCD1, 3, 4, 13, 14, 23, 24) に関連するの別のサ プアセンプリが存在する。このマイクロソフトウェアサ プアセンブリを参照符号MICで示す。該サブアセンブ リは以下のモジュールを含む。

【0082】構造エレメントHA1~GA1, DA1~D As, PR1, PR2, CA1, CA2, DE1, DE2の各 々のハードウェアコンポーネント全体を初期化するよう。 に構成されたモジュールmi。この初期化はより詳細に は2つのコントロールユニットUC1及びUC2の電源投 入時のこれらのハードウェアコンポーネントの種々の試 験に関係する。これらの試験は英語の頭文字BIST及 びBOOTとして実際によく知られている。

【0083】2つのコントロールユニットの電源投入時 に種々のハードウェア構造の相互接続に関係し且つMult ibus IIに関する上記IEEE規格1296により規定 される接続用モジュールm2 (英文用語interconnect sp aceとして知られる)。

【0084】コントロールユニットの各々を2つの電源 ALIM₁及びALIM₂に接続する規格化RS 232 型のワイヤリンク(これらのリンクは図1、図2及び図 3では簡単にするために図示せず)の管理のためのモジ ュールms。

【0085】サプアセンプリHは以下のモジュールを含 t.

【0086】モジュールMoはホストアダプタのオペレ ーティングシステムに係る。以下に示すように、このモ ジュールMoはサブアセンプリP, H, D, C, Sに共 通である。このモジュールは、一方から他方への通行を 30 確保することにより夫々が帰属するサプアセンプリ(こ の場合H)を構成する種々のモジュール間の連係作業を 組織する。

【0087】サプアセンブリP、H、D、C、Sに共通 の情報(データ、アドレス)の転送を管理するためのモ ジュールM1。該モジュールはMultibus IIバス (B1, B₂)の一方又は他方を介してこのモジュールが搭載さ れているハードウェアエレメント(この場合H)から他 のエレメントへの情報の転送を確保する。

【0088】ホストアダプタHAIのホストインターフ 40 ェース I H₁の管理のためのモジュールM₂。このモジュ ールは全ホストアダプタHAI~HAIに共通であること が理解されよう。

【0089】メモリRAHIの命令RAMに含まれるコ マンドスタックの管理のためのモジュールMs。該モジ ュールは他のサプアセンプリH, D, Sに共通である。

【0090】ホストH1によりコントロールユニットU C1及びUC2にアドレスされるコマンドを実行するため のモジュールMィ。

14

MDIのディスクメモリへのコマンドを受け取り、これ らのコマンドをディスクアダプタDA1 に経路指定する モジュールMs。

【0092】ホストアダプタのハードウェアコンポーネ ントの一方又は他方にエラーが検出されたときに再始動 及びエラー処理するためのモジュールMe。このモジュ ールはサプアセンブリH、D及びSに共通である。

【0093】例えばサンプリングを実施する監視及び管 理モジュールMrは、モジュールmz (上述)との接続、 例えばホストアダプタが属するコントロールユニットの 10 電源が切断した場合にコンテキストの救済、テーブル初 期化等を確保する。このモジュールはサブアセンブリ H. D及びSに共通である。

【0094】ホストパッファメモリMTH1の管理のた めのモジュールMin。

【0095】ホストアダプタDA1に搭載されるサプア センブリDは、上記に規定したモジュールMoと、同様 に上記に規定したMultibus II転送管理用モジュールMi と、上記に規定したコマンドスタックの管理のためのモ 20 ジュールMsと、上記に規定したパッファメモリMTD1 の管理のためのモジュールMioと、上記に規定した再始 動及びエラー処理モジュールMoと、上記に規定した監 視及び管理モジュールM7と、セントラルホストからバ ンクBMDiのディスクメモリの一方又は他方へのコマ ンドを翻訳するためのモジュールMoとを含む。

【0096】ソリッドステートディスクユニットDE1 及びDE2のマイクロソフトウェアサブアセンブリS は、マイクロソフトウェアサプアセンブリDと厳密に同 一である。

【0097】キャッシュメモリCA1, CA2のマイクロ ソフトウェアサプアセンプリCは、モジュールM。(上 記)と、Multibus IIパスの一方又は他方を経る情報の 転送を管理するためのモジュールM1(上記)と、キャ ッシュメモリCA1、CA2に含まれるテーブルを管理す るためのモジュールMilとを含む。

【0098】2つのセントラルプロセッサPR1及びP R2の各々に搭載されるマイクロソフトウェアサプアセ ンプリPは、オペレーティングシステムに関するモジュ ールM。(上記)と、Multibus II転送を管理するための モジュールM1(上記)と、対応するコントロールユニ ット(UC1, UC2)の初期化モジュールM12と、2つ のコントロールユニット間の通信用モジュールであっ て、特に一方のコントロールユニットの構造エレメント の1つが使用不能の場合にこれらの2つのコントロール ユニット間で情報交換を設定するように構成されたモジ ュール(このとき、他方のユニットの対応する構造エレ メントは使用不能なエレメントにより通常実施されるオ ペレーションを実行するように構成される) M13と、電 源ALIM₁ (ALIM₂)と本発明の周辺サプシステム 【0091】例えばセントラルホストH1からパンクB 50 の保守を担当するオペレータに用意された保守盤とを管

理するためのモジュールM11と、電源が切断された場合 に対応するコントロールユニット全体のコンテキストを 救済するためのモジュールMisと、電源が切断され、前 記モジュールMieにより対応する救済が行われた後にソ リッドステートディスクユニットDE1, DE2の書き込 み又は読み取りオペレーションを再始動するためのモジ ュールM17と、バックアップディスクメモリMSD ı (MSD₂) とこれに関連するセントラルプロセッサ (即ち P R1) との間のインターフェースを管理するた めのモジュールMisとを含む。

【0099】上記マイクロソフトウェアサプアセンブリ の各々がどのように作動するか、及び該サブアセンブリ を構成するこれらのモジュールの各々が他のモジュール との関連でどのように作用するかについては、ディスク メモリバンクBMD1 及びキャッシュメモリCA1, CA 2の内側のオペレーションに関する特に図7A及び図7 B並びに図8A及び図8Bと共に以下の説明から良く理 解されよう。

【0100】まず最初にセントラルプロセッサPR ı (PR₂) のサプアセンブリPの役割を大まかに説明し 20 よう。

【0101】2つのセントラルプロセッサPR1及びP R2は、コントロールユニットUC1及びUC2の各々に 属する種々のハードウェアエレメントの夫々親装置であ る。該セントラルプロセッサは、夫々に割り当てられた 機能を実行できるように種々のエレメントHA1~H As. DA1~DAs, DE1, DE2, CA1, CA2の実 行プログラムを内側にロードする。当然のことながら、 これらのプログラムの実行は上記機能サブアセンブリ H, D, C, Sに対応する。プロセッサPR₁及びPR₂ 30 は、例えばパックアップ回転ディスクメモリMSDi及 びMSD2に保存されたこれらのプログラムを探索す る。その場合、これらのパックアップメモリはデュアル 機能、即ちまず第1にアダプタDA1, DA2等が使用不 能な場合に、まだ保存されずにパンクBMD1、BMD2 等の回転ディスクメモリへの書き込みを待機している情 報をバックアップする機能と、第2に上記実行プログラ ムを保存する機能とを有する。しかしながらこれらのプ ログラムは、プロセッサPR1及びプロセッサPR2の両 方に接続されたシステムディスクメモリと呼称される特 40 ためのファイルを探索する。 別のディスクメモリに保存され得る。以下の説明では、 バックアップ回転ディスクメモリMSD1及びMSD2も システムディスクメモリの役割を果すと仮定する。

【0102】本発明の周辺マスメモリサプシステムの初 期設定は以下のように行われる。

【0103】各コントロールユニット(UC1, UC2) は電源を入れると自動的にプートロードされるように構 成されている。ブートロード(即ちコントロールユニッ トを含む構造エレメントのハードウェア構造の各々にお

行) は、 (パックアップディスクメモリがシステムディ スクメモリの役割を果すため)バックアップディスクメ モリ中のファイルから行われる。初期設定は順次以下の オペレーションの実行を含む。

【0104】ハードウェア構造の各々についてマイクロ コントローラMCH1, MCD1, 3, 4, 13, 14, 23,24はモジュールmiの命令を実行し、そのハー ドウェアコンポーネントを初期設定する。

【0105】この間PRIのハードウェア構造は、ディ 10 スクメモリMSD」からプートロードされ、他の構造工 レメントの他のハードウェア構造はそれ自体のマイクロ ソフトウェアサプアセンプリがロードされるのを待機す る。換言するならば、セントラルプロセッサPR」はモ ジュールMo, M1, M12, M13, M14, M15, M16及び M17によりRAMメモリ8にロードされる。

【0106】次にプロセッサPR」は、コントロールユ ニットUCIを構成する他のハードウェア構造の各々に ローディングコードを送る。次に該プロセッサは、Mult ibus II型の2つのパスの一方又は他方を介して該ハー ドウェア構造に対応するマイクロソフトウェアサプアセ ンプリ(プロセッサがバックアップディスクメモリMS D₁中で探索し、例えばそのパッファメモリ7中に保存 しておいたサブアセンブリ)を送る。

[0107] エレメント (DE1, CA1, HA1, D A₁) の各々は、該エレメントに含まれるマイクロコン トローラによりモジュール m_0 , m_1 , m_2 , m_3 の各々を 実行することによりそのハードウェアコンポーネントを 初期設定する。次に、該エレメントは実行しようとする マイクロソフトウェアサブアセンブリを含む種々のモジ ュールをロードする。

【0108】システムディスクメモリとしての機能にお いてパックアップディスクメモリが何らかの理由でセン トラルプロセッサPRIによりアクセス不能な場合、こ のセントラルプロセッサは他方のコントロールユニット UC2のセントラルプロセッサPR2によりロードされ る。いったんロードされると、PRiは、UC2のシステ ムディスクメモリとして機能する他方のディスクメモリ MSD2中でコントロールユニットUC1の構造エレメン トのマイクロソフトウェアサプアセンブリをロードする

【0109】コントロールユニットのハードウェア構造 の各々が該ハードウェア構造に対応するマイクロソフト ウェアサプアセンブリを含む全モジュールをロードされ るや否や、こうして形成された構造エレメントは該エレ メントに割り当てられた機能を実行することができる。

【0110】マイクロソフトウェアサブアセンブリがど のように作動するかをよく理解するためには、バンク (例えばBMD₁) のディスクメモリ内に情報を書き込 むオペレーションがHA1, DA1及びCA1にロードさ ける種々のマイクロソフトウェアサプアセンブリの実 50 れるサプアセンブリH, D及びCを含むマイクロソフト

と同一である。

18

ウェアモジュールの各々によりどのように実施されるか を示す図7A及び図7Bをまず参照されたい。

【0111】図6も参照することができ、同図は、HA」及び DA_1 に搭載されるソフトウェアサプアセンプリのモジュールが相互にどのように機能するかを示すと共に、データブロックがパンク BMD_1 (又は BMD_2 等)のディスクメモリの1つとキャッシュメモリ CA_1 (CA_2)との両方で読み取られるときにこれらのモジュールの各々により実施される種々のオペレーションを示す。

【0112】データブロックがBMD1のディスクメモリD1~D6の1つ及びキャッシュメモリCA1で読み取られる時に関連する種々のオペレーションを説明する前に、情報がディスクメモリにどのように書き込まれるか、及びキャッシュメモリの役割についてまず説明することが肝要である。

【0113】データブロックをディスクメモリの磁気デ ィスクに書き込むために、ディスクメモリは各々同一の 長さを有するセクタに分割されている。これは固定フォ ーマットメモリとして知られるディスクメモリで現在一 般に使用されている。種々のセクタはすべて同一のパイ ト数 (例えば512K) を有する。各セクタにはヘッ ダ、データブロック及びフッタが順次書き込まれる。へ ッダは磁気ディスクのトラック上のセクタでヘッダが位 置する物理的位置に情報を含み、フッタはデータの完全 性を確認するための情報を含み、このセクタに記録され る全パイトが正しいか否かを確認する。情報書き込みの ためのこのようなセクタ構成及びセクタ内の分配は非常 によく知られており、従来のディスクメモリで広く使用 されている。本発明の周辺サプシステムでもこの書き込 30 み構成をソリッドステートディスクユニットDE1及び DE2で使用する。

【0114】ディスクメモリに関するオペレーションの過程ではしばしば同一のデータブロックが読み取られることが予想される。換言するならば、経時的に同一のデータブロックへのアクセスの確率は非常に高い。更に、複数のデータブロックが逐次読み取られる場合、第1の所定のデータブロックがいったん読み取られてから同一のデータブロックがこの同一の所定のブロックに引き続いて読み取られる確率も高い。

【0115】上記の理由から、高頻度で読み取られる確率が高いデータを正確に含むキャッシュメモリが使用される。したがって、これらのデータはキャッシュメモリに直接読み取られ、対応するディスクメモリで探索する必要はない。

【0116】データは次に、磁気ディスクメモリのアクセス時間よりも実質的に著しく短いキャッシュメモリのアクセス時間(磁気ディスクメモリの数十ミリ秒に対して約0.1ミリ秒)で読み取られる。

【0117】キャッシュメモリCA1の内側で、情報は 50 ロックを読み取ろうとするリソースを予約する。いった

キャッシュブロックと呼称されるプロックの形態のドーターボード C F C 1 の R A M メモリカラム 2 M 1, . . . , 2 M に書き込まれる。ディスクメモリの各セクタと同様に、該キャッシュプロックの各々はヘッダと、後続するデータ(典型的にはデータフィールドと呼称される)と、後続するフッタとを含む。ヘッダ及びフッタの夫々の役割は、磁気ディスクメモリに記録されるデータのセクタのヘッダ及びフッタ

(0 【0118】単一のキャッシュメモリのデータフィールドは、パンクBMD₁, BMD₂等の1つに属するディスクメモリの磁気ディスクのN(整数)個のセクタに記録される全データに対応する。

【0119】各キャッシュプロックと、所与のディスクメモリに属する所与の磁気ディスクの種々の対応するセクタとの間の対応はテーブルに示される。テーブルは例えばマザーボードCMC」に属するRAMメモリ18のメモリスペースを占有する。

【0120】図7A及び図7Bは、データの一部がキャ20 ッシュメモリCA1で読み取られるか否かに拘わらず、バンクBMD1のディスクメモリのいずれか1つにおけるデータプロックの読み取り時に、ホストアダプタHA1とディスクアダプタDA1との間、ディスクアダプタとキャッシュメモリとの間、及びキャッシュメモリとホストアダプタHA1との間の対話を示す。

【0121】読み取りオペレーションは以下の通りであ ス

【0122】1) ホストアダプタHA: は、例えばメ モリRAH: に配置されるコマンドスタック中に送られ の るコマンドメッセージCMDとしてホストH: からの読 み取り要求を受け取る。このオペレーションはモジュー ルM: 及びM: により順次実行される。

【0123】2) コマンドメッセージCMDの内側でモジュールMs はデータブロックを読み取るべきディスクメモリのアドレスをデコードする。このディスクメモリは簡単にリソースと呼称される。

【0124】3) モジュールMs はリソースのアドレスをデコードするや否や、コマンドメッセージMSG CMDを作成する。

グ 【0125】4) 実際にMultibus II型のメッセージであるこのメッセージMSG CMDは、モジュールM」の指令下にバスB」を通ってディスクアダプタDA」に送られる。

【0126】5) メッセージはモジュール M_9 の指令下にマイクロプロセッサ MPD_1 によりデコードされる。

【0127】6) 該モジュールM。は妥当性をチェックする。

【0128】モジュールMsはホストH;が該当データブロックを読み取るうとするリソースを予約する。いった

んリソースが予約されたらオペレーション100に移る。

【0129】 100: モジュールM₁の指令下で、ディスクアダプタはキャッシュメモリCA₁のプロセッサ16に問い合わせコマンドCIを送る。このコマンドの目的は、データブロックがドーターボードCFC₁のRAMメモリに記憶されているか否かを認識することである。

【0130】 101: キャッシュメモリのテーブルを 管理するためのモジュールM: は該当データブロックの 10 有無を知るためにキャッシュメモリのテーブルを探索す る。

【0131】A) <u>まず応答がイエスであると仮定する</u>。

【0132】キャッシュメモリCA」とホストアダプタ HA」との間に対話が設定される。この対話は次のオペ レーション102A~111を含む。

【0133】 102A: キャッシュメモリ CA_1 のモジュール M_1 は、パッファメモリ MTH_1 のページを予約する要求をホストアダプタに送る。

【0134】 103: ホストアダプタの管理モジュールMs は次に、キャッシュメモリCA1に読み取ろうとするデータブロックを一時的に記憶するために、バッファメモリMTH1のページを割り当てる。バッファメモリのページが割り当てられるや否やオペレーション104に移る。

【0135】 104: ホストアダプタはモジュールM」の指令下に、パスB」を介してキャッシュメモリにメッセージを送り、そのパッファメモリMTH」のページが割り当てられたことを知らせる。

【0136】105: キャッシュメモリのデータプロックは、キャッシュメモリ及びホストアダプタのモジュール M_1 の指令下でパッファメモリ MTH_1 に転送される。

【0137】 106: ブロックの全データがバッファメモリMTH」に記憶されるや否や、ホストアダプタは該当データプロックを転送することをホストH」に通知する。この通知はモジュールM2の指令下に行われる。

【0138】 107: ホスト H_1 が転送を受諾するや否や、モジュール M_2 の指令下にホストアダプタにより転送が実施される。

【0139】 108: オペレーション106及び107が実行されている間、キャッシュメモリは信号HITをディスクアダプタDAIに送り、該当データブロックがキャッシュメモリからホストアダプタHAIに転送されたことを知らせる。このメッセージHITは、キャッシュメモリのモジュールMIによりキャッシュメモリCAIからディスクアダプタDAIに送られる。

【0140】<u>109</u>: ディスクアダプタはメッセージ HITを受け取るや否や、モジュールM₈の指令下で応 50 答メッセージMSG REPTを作成する。

【0141】110: ディスクアダプタは次に、ディスクアダプタ及びホストアダプタのモジュールM₁の指令下で応答メッセージMSG REPをホストアダプタHA₁に送る。

【0142】111: ホストアダプタは応答メッセージMSG REPを受け取るや否やモジュールM2の指令下で完了送信信号を送り、キャッシュCA1におけるデータプロックの読み取りオペレーションが完了したことをホストH1に知らせる。

【0143】B) <u>応答がノーであると仮定する</u>。

【0144】オペレーション101 (上記) に引き続き オペレーション102Bを実施する。

【0145】 102B: キャッシュメモリCA1はそのモジュールM1によりバスB1を通ってディスクアダブタDA1にメッセージを送り、データブロックがそこに存在しないことを知らせる。このメッセージがDA1によりうけとられると、次のオペレーション8に移る。

【0146】8) アダプタDA₁は、リソースで読み取 の られるデータプロックを受け取るためにパッファメモリ MTD₁の1ページ以上を割り当てる(モジュールM₁₀ により実施されるオペレーション)。こうして次のオペ レーションに移る。

【0147】9)モジュールM₈の指令下にリソースにおけるデータブロックの読み取りが実施される。

【0148】10)読み取りが完了すると、データプロックはパッファメモリMTD」の割り当てられたページに一時的に記憶され、アダプタDA」はモジュールM」の指令下にそのパッファメモリMTH」〜HA」のページ割30 り当て要求を送る。

【0149】11) この要求に応答してHA: は該当するデータブロックを受け取るためにそのバッファメモリMTH: のページを割り当てる。

【0150】 12) HA_1 はパス S_1 を介して DA_1 にメッセージを送り、 MTH_1 の1ページ以上が割り当てられたことを知らせる(HA_1 及び DA_1 のモジュール M_1)。

【0151】13) DAI は次にこの最後のメッセージ に応答して、これらの2つのアダプタのモジュールMI の指令下にリソースで読み取られた情報をHAI に転送 する。

【0152】14A)ホストアダプタはモジュールM₂の指令下に、リソースで読み取られ且つバッファメモリMTH₁に一時的に記憶されたデータプロックをすぐに転送するようにホストH₁に知らせる。

【0153】14B)オペレーション14Aしが実施されている間、ディスクアダプタは応答メッセージMSG

REPを作成する。このメッセージはディスクアダプ 夕及びホストアダプタのモジュールM₁ の指令下にHA₁ に送られる(オペレーション15B)。HA₁はこの応

答メッセージを受け取ると、オペレーション15Aを実 行する。

【0154】15A) HA₁はモジュールM₂の指令下でホストH₁にデータプロックを転送する。この間、DA₁はオペレーション15B及び16Bを実行する。

【0155】15B)ディスクアダプタはモジュールM によりリソースを解放し、次いでモジュールM1oの指令下にパッファメモリMTD1を解放する(オペレーション16B)。

【0156】16A)ホストアダプタはホストH₁への 10 データ転送を完了するや否や、ホストに完了送信信号を送り、リソースにおけるデータプロックの読み取りの全オペレーションが完了したことを知らせる(モジュール M₂)。

【0157】17A)ホストアダプタは次にモジュール M1oの指令下にMTH1を解放する。

【0158】図8A及び図8BはキャッシュメモリCA ₁又はBMD₁, BMD₂等のようなパンクのディスクメ モリのいずれか1つにデータブロックを書き込むために 実行される全オペレーションを示す。

【0159】 HA」とDA」との間の対話に関するオペレーションセット1~8は、リソース又はキャッシュメモリCA」におけるデータブロックの読み取りについて図7A及び図7Bに関して上述したオペレーション1~8と厳密に同一である。その後、オペレーション20に移る。

【0160】20)ディスクアダプタDAIは、書き込むべきデータブロックの転送を要求するためにバスBIを通ってホストアダプタHAIにメッセージを送る。このオペレーションは2つのアダプタの2つのモジュール 30 MIの指令下に行われる。

【0161】21)次にホストアダプタは、データブロックを受け取るためにホストバッファメモリ MTH_1 の1ページ以上を割り当てる(モジュール M_{10})。

【0162】 22)次に HA_1 は、書き込むべきデータプロックを転送すべきであることをセントラルホスト H_1 に知らせる(モジュール M_2)。

【0163】23)次にセントラルホストは、オペレーション21で割り当てられたパッファメモリのページに一時的に記憶されていた書き込むべきデータブロック 40を、モジュールM2の指令下に転送する。

【0164】 24)次に HA_1 は、書き込むべきデータプロックを後で受け取るためにバッファメモリ MTD_1 の $1ページ以上を割り当てるように要求するメッセージを<math>DA_1$ に送る(2つのアダプタのモジュール M_1)。

【 0 1 6 5 】 2 5) このメッセージに答えてDA1 はM TD1 の 1 ページ以上が割り当てられたことを知らせるメッセージをHA1に送る(モジュールM1)。

【0166】26)次にHAIは書き込むべきデータプ れる ロックをDAIに転送し、DAIは先に割り当てられたM 50 る。

TD₁のページに該データプロックを一時的に記憶する。

【0167】27)MTD1に書き込むべきデータプロックを受け取ると、DA1は応答メッセージMSG REPを作成する(モジュールM9)。DA1はモジュールM1の指令下に該応答メッセージをHA1に送る(オペレーション28)。

【0168】29)HAIはメッセージMSG REPを受け取ると、モジュールMiの指令下に完了送信信号をホストに送る。ホストHIにとってこのメッセージは、予約されたリソース又はキャッシュメモリCAIのいずれかで(実際にはまだであるが)データブロックの書き込みオペレーションが完了したことを意味する。

【0169】次にオペレーション30に進む。

【0170】30)モジュールMsの指令ドで、アダプタDA1は該当リソースにデータプロックを書き込む。この書き込みと平行してディスクアダプタは、モジュールM1の指令下に2つのパスB1,B2の一方又は他方を通ってコマンド信号CIWをキャッシュメモリCA1に20 送る。この信号の目的は、書き込むべきデータブロックをそのメモリCFC1に書き込むことができるか否かを該キャッシュメモリに尋ねることである。コマンド信号CIWを送ることがオペレーション128の目的である。

【0171】129: 128に答えてキャッシュメモリはモジュールM11の指令下に、データプロックをキャッシュメモリに書き込むべきであることを意味する信号HIT、又はそうすべきでないことを意味する信号HITが一をディスクアダプタに送る(前者はオペレーション130A、後者は130B)。自明のように後者の場合、オペレーション130Bに答えてディスクアダプタは以後、キャッシュメモリCA1を無視する。前者の場合(130A)、手続きはオペレーション131に進む。

【0172】<u>131</u>: ディスクアダプタはメモリCF C₁に書き込む前に書き込むべきデータブロックを一時的に記憶するために、キャッシュパッファメモリ17の1ページ以上の予約を要求するメッセージをキャッシュメモリに送る。このオペレーションはDA₁及びCA₁のモジュールM₁の指令下に行われる。

【0173】 132: CA_1 のモジュール M_1 の指令下に、 CA_1 はパッファ1701ページ以上が書き込むペきデータプロックを一時的に記憶するために割り当てられたことを DA_1 に知らせる。

【0174】133: オペレーション132に答えて、 DA_1 は CA_1 のバッファメモリ17に書き込むべきデータプロックを転送する。

【0175】<u>134</u>: データプロックは17に転送されるや否やM₁₁の指令下にメモリCFC₁に転送される。

【0176】オペレーションセット128A~134はオペレーション30(上記)と平行して実施される。

【0177】このオペレーション30後、手続きはオペレーション31に移る。

【0178】31)書き込むべきデータプロックセット が書き込まれると、モジュールMaはリソースを解放する。

【0179】32)リソースがいったん解放されると、 モジュールMioは先に割り当てられていたパッファメモ リMTDiのページを解放する。

【0180】33)いったんオペレーション32が完了すると、DAIはモジュールMIの指令下にホストアダプタにメッセージを送り、オペレーション34でそのホストバッファメモリMTHIを解放できるようにする。

【0181】ホストアダプタ HA_1 が使用不能であることが判明したならば、該ホストアダプタは UC_2 の対応するアダプタ HA_2 で代替される。同様に、 DA_1 は DA_2 で代替される。こうして、 B_2 を介して HA_2 , DA_2 及び CA_2 の間に対話が設定される。

【0182】ユニットUC1全体が使用不能であるならば、CA1に含まれ、同様にCA2にも書き込まれたデータはCA2で直接読み取られ、HA1、DA2及びCA2の間で対話が行われる。この場合も、キャッシュメモリCA1、CA2へのデュアルアクセスと、CA1及びCA2の両方に書き込まれる冗長性の利点は明らかである。

【0183】図6、図7A、図7B、図8A及び図8Bから明らかなように、所定数のモジュールは、ホストアダプタ、ディスクアダプタ又はキャッシュメモリのいずれであろうとも、ハードウェア相互間で共通の多数のオペレーションを実行する。例えばモジュールM2及びM10がその例である。モジュールM2、M9及びM8の重要性にも着目されたい。

【0184】所定のデータプロックの全読み書きオペレ ーションは、2 つのソリッドステートディスクユニット DE1及びDE2に関して同一の方法で実施されることに 留意すべきである。回転ディスクメモリと同様に、書き 込むべきデータプロックは同一バイト数を含むセクタに 分割され、1つのセクタの情報の組は相互に連続するア ドレス、例えばユニットアドレスを有する記憶場所に書 き込まれる。本発明の好適実施態様によると、データは 40 7エラー修正ピットECC (エラーコレクタコード) に 加えられる4パイトに分配される有効な39又は32ビ ットのフォーマットとして書き込まれ、このエラーコレ クタコードはダイナミックRAMメモリで従来から使用 されている。図7A、図7B、図8A及び図8Bに示す ような読み書き方法をDEI又はDEIのようなソリッド ステートディスクも良好に使用できるようにするために は、以上の全説明でディスクアダプタDA1をマザーボ ードCMD: に置き換えれば十分であり、マイクロプロ セッサ26はマイクロプロセッサMPDiと同一の役割

24

を果し、バッファメモリ27はディスクアダプタのバッファメモリMTD₁と同一の役割を果す。データがメモリCFD₁にいったん書き込まれると、バックアップディスクメモリMSD₁は遮蔽時間で更新され、メモリCFD₁に書き込まれたプロックと同一のデータプロックを受け取り、これらのデータはホストバッファMTH₁に由来する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の周辺サプシステムのハードウェアアー 10 キテクチャの最も単純な形態である第1の実施態様の説 明図である。

【図2】本発明の周辺サプシステムのハードウェアアーキテクチャの最も複雑な形態である第2実施態様の説明図である。

【図3】ホストアダプタ及びメモリアダプタのハードウェア構造の詳細図である。

【図4】本発明の周辺サプシステムの2つのコントロールユニットの一方のセントラルプロセッサ、キャッシュメモリ及びソリッドステートディスクユニットのハード20 ウェア構造の詳細図である。

【図 5】本発明の周辺サプシステムのコントロールユニットを構成するハードウェアエレメントの各々にマイクロソフトウェアアーキテクチャの種々の機能サプアセンプリをどのように搭載するかを示す説明図である。

【図 6】ホストアダプタ及びメモリアダプタに固有のマイクロソフトウェアアーキテクチャの機能サプアセンプリが夫々どのように構成されるかを示す構成図である。

【図7A】キャッシュメモリとマスメモリのディスクメモリの1つとの両方でデータプロックの読み取りオペレーションを実行できるように、ホストアダプタとディスクメモリアダプタとの間、及びこれらのアダプタとキャッシュメモリとの間の対話を説明するフローチャートである。

【図7B】キャッシュメモリとマスメモリのディスクメモリの1つとの両方でデータプロックの読み取りオペレーションを実行できるように、ホストアダプタとディスクメモリアダプタとの間、及びこれらのアダプタとキャッシュメモリとの間の対話を説明するフローチャートである。

7 【図8A】 キャッシュメモリとマスメモリのディスクメモリとの両方への書き込みオペレーションを実行できるように、ホストアダプタとディスクメモリアダプタ間及びこれらのアダプタとキャッシュメモリとの間の対話を示すフローチャートである。

【図8B】 キャッシュメモリとマスメモリのディスクメモリとの両方への書き込みオペレーションを実行できるように、ホストアダプタとディスクメモリアダプタ間及びこれらのアダプタとキャッシュメモリとの間の対話を示すフローチャートである。

50 【符号の説明】

PSS₁, PSS₂ 周辺マスメモリサプシステム H₁, H₂, H₃, 4₄ セントラルホスト UC₁, UC₂ コントロールユニット BMD₁, BMD₂ マスメモリ ALIM₁, ALIM₂, BAT₁, BAT₂ 電源 PR₁-PR₂, DE₁-DE₂, CA₁-CA₂, HA₁- HA2, DA1-DA2構造エレメント B1, B2 パス AML マイクロソフトウェアアーキテクチャ B, H, D, C, S 機能マイクロソフトウェアサプア センブリ

PSS1 UC2 ALIPM2
BAT1 PS UC2 BAT2

CE2 1/2 1/3 CE1 PR1 PR2 DE2 HA2

CA1 CA1 CA1 DE1

CS ST CS4

CS ST CS5

CS ST CS4

CS ST CS5

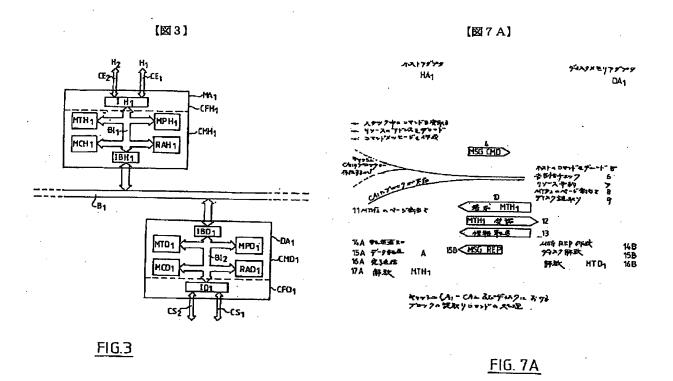
CS ST CS5

CS ST CS5

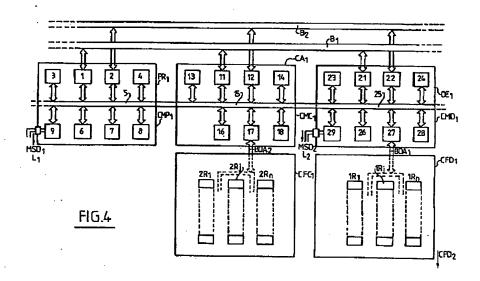
CS ST CS

FIG.1

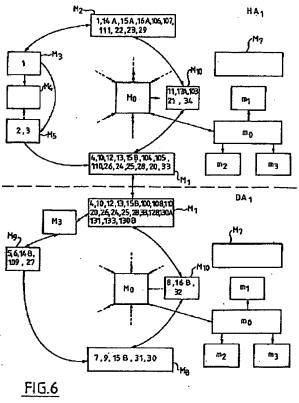
| MSD3 | MSD4 | MSD5 | MSD6 | MSD2 | MSD2 | MA2 | MA4 | MA4 | MA4 | DE1 | CA1 | PR1 | PR2 | CA2 | DE2 | B2 | MA2 | MA4 | DA6 | DA8 | DA9 |



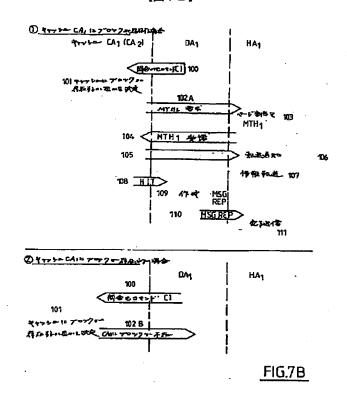
【図4】



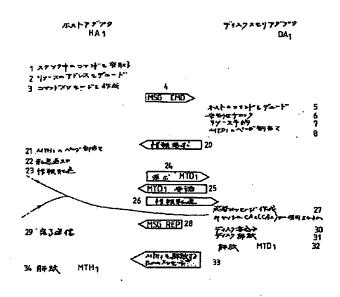




【図7B】



[図8A]



Techary Page

FIG.8A

[図8B]

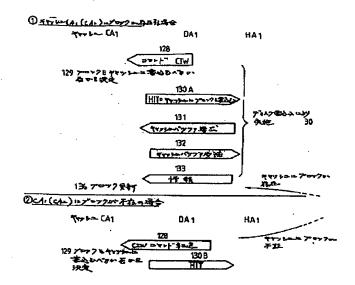


FIG.8B

フロントページの続き

(72)発明者 パトリスイア・ジヤコミニ フランス国、78390・ボア・ダルシ、リ ユ・バラゲ、12